

平成25年度事業計画書

自：平成25年4月1日 至：平成26年3月31日

1. 全般

- (1) 本学会の運営の基本方針として次の項目に示す活動を推進する。
 - ① 世界をリードする実装技術のけん引役としての活動
 - ② 幅広い技術領域をカバーしていることを活かし展開
 - ③ 将来を担う若い実装技術者の育成と魅力ある活動の場の提供
- (2) 学会活動の活性化を図るために、会員増強活動を引き続き展開するとともに、会員主体の学会活動をより推進するために、学会運営の公平性と透明性の強化に努める。従来からの学会活動に加え、新しいアイデア、新しい概念、新しい考え方を注入して、イノベーションを起こした革新的な活動を推進する取組みに努める。
- (3) 技術調査事業については、引続き、学会の基盤活動である技術委員会および研究会の活動を強化・活性化するとともに必要に応じて組織の見直しを検討する。新規テーマや横串的な研究会活動を活発化するとともに、技術委員会および研究会の運営についても、支出内容の見直しを含め自立化かつ健全化を推進する。
- (4) 大会事業については、春季講演大会、秋季大会マイクロエレクトロニクスシンポジウム、国際会議ICEP、ワークショップを実施する。これらのイベントへの参加者および発表者の増加を図るため、新分野のセッション企画などを強化するとともに、収支改善のため運営の合理化を進める。さらに、各行事の将来の方向性、運営の充実を図るための仕組みづくりを考えていく。
- (5) 展示会事業については、JPCAShow/マイクロエレクトロニクスショー/JISSO PROTEC/ラージエレクトロニクスショーの4展示会の活性化と来客数の増加を図るため、最先端実装技術シンポジウム、アカデミックプラザ、及び、eX-techを実施するなど内容を充実していく。また半導体関連分野の企業との連携を強化するため、セミコン・ジャパンにおいて学会活動紹介展示と実装技術セミナーの開催を行う。
- (6) 教育事業については、将来を担う実装技術者、若手技術者を育成するためにきわめて重要であり新たな取組みや充実した活動を目指していく。具体的には、教育講座2件、教育セミナー2件に加え、新たに若手会員のニーズに応えられるよう演習などを加えた教育講座を開催する。
- (7) 会誌発行事業は、学会活動のアウトプットとして重要であり、例年通り学会誌を7回、英文論文誌を1回発行するとともに、会員の利便性向上と会誌発行費用の削減を図るため、電子Web化をさらに推進するとともに、広告掲載料の増収にも努力する。学会誌への投稿は、JSTの電子投稿システムを本格運用する。英文論文誌は冊子印刷を止め電子閲覧のみとし、経費圧縮をするとともに、海外への情報発信を強化するため英文HPに掲載して公開する。
- (8) 国際事業については、国際会議ICEPを機軸に、IEEE CPMT、IMAPSとの国際交流活動を継続し、具体的な活動につなげる。ICEPの開催に関してIEEE CPMTおよびIMAPSとMOUの締結を更新し、具体的協力体制を構築していく。
- (9) 支部事業については、支部の主体性を尊重しつつ、活動を推進していく。関西支部は前年と同様に、若手研究者セミナー、技術講演会、関西ワークショップ、“ぷらっと関西”を開催するとともに、九州支部は自主イベントを開催し、地域活動の活性化を図る。関西支部10周年記念講演会は、海外からの招待講演も含めて企画する。また、東北・北海道地区の活動を強化し、支部化へ向けた準備を進める。
- (10) 表彰事業活動については、例年通り、学会活動の活性化を目的に、学会活動に功績のあった方および学術的・技術的に貢献があった方に学会各賞を贈呈する。

2. 学会運営体制

(1) 財務体質の安定化

永続的に学会が運営できる財務基盤の確立を目指し、費用の見直しと収益の改善に、より一層の努力をする。

(2) 会員数の増強

前年度に引き続き、会員数の増強に積極的に取り組む。平成 23 年度から導入したシニア会員制度および賛助会員向けの特典（クーポン券）の効果を評価するとともに、イベントの収支に与える影響についても調査する。

3. 大会事業活動（定款第 4 条第 1 号関係）

(1) 「国際会議 ICEP 2013」を 2013. 4. 10～12 に大阪国際会議場にて開催する。IEEE CPMT Japan および IMAPS と共催し、当学会の国際的プレゼンスを向上させ国際交流を推進する。

(2) 「第 23 回秋季大会マイクロエレクトロニクスシンポジウム」を 2013. 9. 12～13 に大阪大学 吹田キャンパスで開催する。実装分野の企業・大学・公共研究機関の最新の研究・開発の成果発表と情報交換の場を提供する。活性化の施策として“ものづくりセッション”、大学研究室紹介コーナーを企画するとともに、収支改善に努める。

(3) 2013 ワークショップを 2013. 10. 17～18 にラフォーレ修善寺を開催する。注目されている実装技術について、発表者と参加者と双方向のディスカッションにより理解を深めるイベントとして提供する。活性化を図り参加者を増やすとともに収支改善に努める。

(4) 「第 28 回春季講演大会」を 2014. 3. 5～7 に拓殖大学で開催する。実装分野の企業・大学・公共研究機関の最新技術開発の発表と情報交換の場を提供するとともに、ものづくり技術の紹介により企業からの参加の機会を増やすとともに、チュートリアル講義により若手研究者の参加者増も図り、活性化を図るとともに収益増に努める。

4. 展示会事業活動（定款第 4 条第 1 号関係）

(1) JPCAShow/マイクロエレクトロニクスショー/JISSO PROTEC/ラージエレクトロニクスショーの 4 展示会(2013. 6. 5～7 東京ビッグサイト)の活性化と集客増員に寄与することを目的に、「最先端実装技術シンポジウム」、「アカデミックプラザ」及び「eX-tech」を実施する。また、これらのイベントをマイクロエレクトロニクスショーの中のイベントとして、位置づけを明確化するとともに個々の活性化と連携を深め効率的な運営を行う。

(2) 「セミコン・ジャパン 2013」(2013. 12. 4～6 幕張メッセ)に当学会の活動を紹介するブースの出展と実装技術セミナーの開催により、引き続き、半導体分野への会員拡大と連携を推進する。

5. 技術調査事業活動（定款第 4 条第 2 号関係）

(1) 技術委員会の活動

13 技術委員会を組織し、各実装技術分野について、技術動向の調査活動を推進する。それらの活動で得られた成果をもとに、技術展望などについては学会誌に掲載するとともに、大会行事や最先端実装技術シンポジウムなどへの支援も行う。

(2) 研究会の活動

新設、統合された「官能検査自動化研究会」、「先端実装・電子部品研究会」、「環境と実装研究会」を含め、23 研究会を組織し、具体的な個々の実装関連テーマについて調査活動を推進する。委員相互の情報交換や、必要に応じて試料作製から測定・評価を行い情報が共有できる場を提供する。引き続き、研究会運営の自立性と横断テーマなどの新規分野の研究会創設を目指す。

(3) 技術調査事業活動成果の普及

技術委員会および研究会の活動で得られた成果については、公開研究会や学会誌などで広く公開する。

6. 教育事業活動（定款第4条第3号関係）

(1) 教育講座

実装分野の研究開発者の育成に寄与するため「実装技術入門講座-初級コース」（2013. 6. 27～28）と「実装技術総合講座」を継続する。

(2) 教育セミナー

例年どおり、教育的見地から、注目されている実装技術をテーマとした「定例セミナー」を2回開催する。

(3) 演習付き教育講座

演習付き教育講座として、伝熱解析に関するテーマで開催を計画する。演習時間を充実するなどカリキュラムを工夫して実施する。

7. 会誌発行事業活動（定款第4条第4号関係）

(1) エレクトロニクス実装学会誌の発行

JSTの電子投稿システムを本格運用して、例年通り、機関誌「エレクトロニクス実装学会誌」を7回発行する。研究開発活動の成果として研究論文、総合論文、速報論文、解説等を掲載し、実装技術に関する最新情報を会員に提供する。また、理事会や各事業委員会の活動状況についても広報する。

(2) 英文論文誌の発行

本学会の国際的な認知とプレゼンスの向上を図るため、引き続き、英文論文誌（Transactions of The Japan Institute of Electronics Packaging Vol.6）を発行する。費用圧縮のため、電子閲覧を基本とし、冊子は希望者に有料で配布とするように変更する。国際的なプレゼンス向上のため、英文HPで電子閲覧できるようにして、海外への情報発信を活性化する。

(3) 韓国語翻訳転載

学会誌の研究論文、解説論文の一部を韓国語の雑誌への翻訳・転載を継続する。当学会会員の国際的なプレゼンス向上と技術の国際普及に貢献する。

8. 国際事業活動（定款第4条第5号関係）

(1) IMAPS との連携

米国 IMAPS の年会に設けられている Japanese Session の企画への協力など、IMAPS 対応委員会を通じて連携した活動を継続する。本学会会員に、Affiliate 会員として IMAPS に入会できる便宜を図る事業も継続する。アジアの IMAPS 系地域組織との交流では、Asia Liaison Committee に役員を派遣し、コンファレンスの企画に参加するなどの活動を推進する。ICEP 開催については IEEE CPMT と同様に、IMAPS に共催を依頼する MOU を締結する。

(2) IEEE CPMT Society との連携

国際会議 ICEP2013 については、引き続き、IEEE CPMT Japan Chapter には共催いただくとともに、論文発表の勧誘や優秀な論文の表彰などを連携して実施する。IEEE CPMT Japan Chapter が主催するイベントと本学会の行事に相互に協賛するなど、本学会会員に国際交流活動の場を提供するとともに、当学会の国際的なプレゼンスを高める機会とする。

9. 支部事業活動（定款第4条第6号関係）

(1) 関西支部の活動計画

若手研究会セミナー（2013年6月と12月開催予定）、技術講演会（2014年2月開催予定）、関西ワークショップ（2013. 7. 18～19）、および見学会付き講演会の「ぷらっと関西」のイベントを、引き続き実施する。技術講演会については、関西支部10周年記念講演会として、海外からの招待講演も含めて企画する。関西ワークショップは前回同様、経験豊かな先輩を囲んでのナイトセッション

ョン等を企画し、参加者の増員を図る。

(2) 九州支部の活動計画

九州支部の独自イベントとして、技術講演会と若手研究会セミナーを企画して支部会員の情報交流の場を提供するとともに、産業界・大学と連携する活動を行う。

(3) 東北・北海道地区の活動計画

東北・北海道地区の会員数増強の推進体制を構築して、地区の活動基盤を固めていく。

10. 表彰事業活動（定款第4条第6号関係）

学会活動の活性化と研究開発者のモチベーションの向上のため、例年通り、エレクトロニクス実装に関する学術の発展および学会活動に対して功績のあった方に学会賞、功績賞、技術賞、論文賞、技術功労賞を贈呈する。技術功労賞の表彰対象を広げ、学会活動の活性化に役立てる。各種イベント（春季講演大会、秋季大会 MES、国際会議 ICEP）についても、例年通り優秀発表者を表彰する。